

2021年9月度 Web版 SSIS フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

9月度 SSIS フォーラムでは国立大学法人・名古屋大学・教授の宇治原徹様をお招きし、現在世界的に注目を集めているマテリアル・インフォマティクス、およびプロセス・インフォマティクスについてご講演をいただきます。日本が強みとする材料技術をさらに推し進める革新的な技術ですので、皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。

■講演タイトル

『デジタルツインによる素材開発からサイバーファクトリー構想(半導体結晶成長を例にして)』

■講師

国立大学法人・東海国立大学機構・名古屋大学

未来材料・システム研究所・未来エレクトロニクス集積研究センター

教授 宇治原 徹様

< 講演要旨 >

結晶成長において大口径化は非常に困難を伴う。我々はこれまで溶液法による超高品質 SiC バルク結晶成長の技術開発を行ってきた。その結果、超高品質結晶を得ることに成功した。しかし、この技術を社会実装するには、ラボレベルの技術を 6 インチ、8 インチウエハの製造技術にまで高める必要がある。我々は機械学習技術を駆使して実際の結晶成長の代理モデルをコンピュータ内に構築し、大口径化のための最適条件を見出す手法を開発した。それにより、2 年余りで 6 インチ結晶の成長技術にまで高めた。現在では、このプロセスインフォマティクスを様々な結晶成長や素材プロセスにまで展開している。本講演では、インフォマティクスを用いた素材開発を SiC 結晶成長を例に紹介し、本技術の汎用性、発展性、さらにはベンチャー企業が素材開発で大きな力となる可能性について意見を述べる。



< 開催要領 >

1. 日時 2021年9月10日(金) 15時~17時
2. Web ツール Webex(Cisco 社製)を使用
3. 参加費 会員(個人、賛助、準):無料
一般:3,000 円(消費税込み)
4. 締め切り 9月3日(金)
ただし、100名に達した時点で締め切らせていただきます。
5. 参加申し込み法と Web 版 SSIS フォーラム参加法
(1)メールタイトルに「2021年9月度 SSIS フォーラム参加申し込み」とご記載ください。

(2) メール文に、ご氏名、ご所属、メールアドレス、**会員、または一般**、をご記載ください。

(3) 半導体産業人協会・講演企画委員会宛てに、メールをご送付下さい。

講演企画委員会アドレス: koenkikaku@ssis.or.jp

なお、事務局 (info@ssis.or.jp) ではフォーラムの受付をしておりませんので、ご注意ください。

(4) 一般の方への受付確認メールには、半導体産業人協会の銀行口座番号を記載します。口座に**参加費 3,000円(消費税込み)をお振込み**ください(振込手数料は申込者負担)。お振込み後はキャンセルできません。

(5) 一般の方も、当協会にご入会いただくと、2021年度会費無料で会員に登録できます。その場合は本フォーラムにも無料参加できます。下記サイトからご入会下さい。

<http://www.ssis.or.jp>

[個人会員、準会員入会のご案内 | 一般社団法人半導体産業人協会 \(ssis.or.jp\)](#)

ご質問がある場合、koenkikaku@ssis.or.jp 宛にメールでお問い合わせをお願いします。SSISフォーラムの情報、協会の活動の最新情報は、ホームページでもご覧いただけます。

(6) Webex を初めて利用される場合、下記の接続手順を参考にして下さい。

<https://help.webex.com/ja-jp/n665eiq/Join-a-Cisco-Webex-Meeting-for-the-First-Time-as-a-Guest>

また、Webex のさらに詳しい利用方法については、下記の「使い方ガイド」をご一読下さい。

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html

一般社団法人 半導体産業人協会

<http://www.ssis.or.jp>

TEL:03-6457-3245

FAX:03-6457-3246
